

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临 2010-001 号

方正科技集团股份有限公司

第八届董事会 2010 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

方正科技集团股份有限公司于 2010 年 2 月 9 日召开公司第八届董事会 2010 年第一次会议，本次会议采用传真表决方式。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。参会董事一致审议通过了如下议案：

一、 审议通过了关于调整公司 2009 年度配股项目及延长配股有效期的议案。

公司 2009 年度配股方案已经公司第八届董事会 2009 年第二次会议和公司 2008 年度股东大会审议通过。

1、关于调整公司 2009 年度配股项目议案

根据目前公司的资金需求，为了更好的实现全体股东利益最大化，公司决定调整公司 2009 年度配股项目如下：

原方案：

5、本次配股募集资金的用途：

（1）拟增资珠海方正高密电子有限公司用于新扩建 HDI 项目，金额不超过 56,298 万元人民币；

（2）拟增资珠海方正高密电子有限公司用于新建快板项目，金额不超过 15,255 万元人民币；

（3）拟增资重庆方正高密电子有限公司用于继续建设背板项目，金额不超过 36,991 万元人民币；

（4）拟增资方正科技集团苏州制造有限公司 20,000 万元人民币，用于补充 PC 业务流动资金。

本次配股拟募集资金不超过 128,544 万元人民币，投入上述四个项目。本次配股募集资金投资项目符合国家产业政策，具有良好的发展前景。项目投入不

足部分公司自筹资金解决，本次配股资金到位前，公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入部分在募集资金到位之后予以偿还，本次配股资金到位后，将按项目投资计划及市场情况安排使用。

现调整为：

5、本次配股募集资金的用途：

（1）拟增资珠海方正高密电子有限公司用于新扩建 HDI 项目，金额不超过 56,298 万元人民币；

（2）拟增资珠海方正高密电子有限公司用于新建快板项目，金额不超过 15,255 万元人民币；

（3）拟增资重庆方正高密电子有限公司用于继续建设背板项目，金额不超过 36,991 万元人民币。

本次配股募集资金净额不超过 108,544 万元人民币，投入上述三个项目。本次配股募集资金投资项目符合国家产业政策，具有良好的发展前景。项目投入不足部分公司自筹资金解决，本次配股资金到位前，公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入部分在募集资金到位之后予以偿还，本次配股资金到位后，将按项目投资计划及市场情况安排使用。

2、关于延长公司 2009 年度配股有效期议案

延长公司 2009 年度配股方案有效期一年：自公司 2010 年度第一次临时股东大会通过本议案之日起十二个月内有效。

本次调整后公司 2009 年度配股方案具体如下：

1、本次配售股票类型及面值：人民币普通股（A 股）；每股面值：人民币 1 元。

2、本次配股基数、比例和数量：

以公司截止 2008 年 12 月 31 日总股本 1,726,486,674 股为基数，按每 10 股配 3 股的比例向全体股东配售，本次配股可配售股份总计为 517,946,002 股。

3、本次配股定价方式及配股价格：

本次配股的定价原则：

- (1) 配股价格不低于公司最近一期的每股净资产值；
- (2) 募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排；
- (3) 参考公司股票在二级市场价格和市盈率情况；
- (4) 与主承销商协商确定。

本次配股价格：在不低于公司最近一期每股净资产的基础上，依据本次配股确定的定价原则，采用市价折扣法确定配股价格。

4、本次配股配售对象：

待本次配股获得中国证券监督管理委员会核准后，公司将确定本次配股股权登记日，配售对象为本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

5、本次配股募集资金的用途：

(1) 拟增资珠海方正高密电子有限公司用于新扩建 HDI 项目，金额不超过 56,298 万元人民币；

(2) 拟增资珠海方正高密电子有限公司用于新建快板项目，金额不超过 15,255 万元人民币；

(3) 拟增资重庆方正高密电子有限公司用于继续建设背板项目，金额不超过 36,991 万元人民币。

本次配股募集资金净额不超过 108,544 万元人民币，投入上述三个项目。本次配股募集资金投资项目符合国家产业政策，具有良好的发展前景。项目投入不足部分公司自筹资金解决，本次配股资金到位前，公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入部分在募集资金到位之后予以偿还，本次配股资金到位后，将按项目投资计划及市场情况安排使用。

6、本次配股承销方式：

本次配股采用代销方式。

7、本次配股决议的有效期限：

自公司 2010 年度第一次临时股东大会通过本议案之日起十二个月内有效。

本次调整公司 2009 年度配股项目及延长配股有效期议案须经公司 2010 年度第一次临时股东大会表决通过后，报中国证券监督管理委员会核准后实施。

二、 审议通过了关于公司 2009 年度配股募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案。（详见附件一）

该议案将提交公司 2010 年度第一次临时股东大会审议。

三、 审议通过关于提请股东大会授权董事会继续全权办理 2009 年度配股相关具体事宜的议案，授权范围如下：

（1）授权董事会全权办理本次配股申报事宜；

（2）在本次配股申报期间，授权董事会可依据证券监管部门的审核意见，根据市场变化和公司发展的需要，对募集资金投向进行适当的调整；

（3）根据有关主管部门的要求和证券市场的实际情况，授权董事会在股东大会决议范围内确定本次配股实施时间、配股价格、配售数量、发行起止日期等具体事宜；

（4）授权董事会签署本次募集资金投资项目运行过程中的有关重大合同和重要文件；

（5）授权董事会聘请有关中介机构；

（6）授权董事会签署与本次配股有关的各项文件及合同；

（7）授权董事会根据本次配股实施结果，修改《公司章程》相关条款并办理工商变更登记；

（8）配股方案有效期内，若配股政策发生变化，授权董事会按新政策继续办理本次配股事宜；

（9）若控股股东不履行认配股份的承诺，或者配股代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十的，授权董事会按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东；

（10）相关法律法规允许的情况下，授权董事会办理其他与本次配股有关的事宜。

本授权自公司 2010 年度第一次临时股东大会通过本议案之日起 12 个月内

有效。

四、 审议通过了关于召开公司 2010 年度第一次临时股东大会的议案，本次股东大会主要议程如下：

- 1、审议关于调整公司 2009 年度配股项目及延长配股有效期的议案；
- 2、审议关于公司 2009 年度配股募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案；
- 3、审议关于提请股东大会授权董事会继续全权办理 2009 年度配股相关具体事宜的议案。

公司 2010 年度第一次临时股东大会召开时间为 2010 年 2 月 26 日，股权登记日 2010 年 2 月 22 日，会议登记日为 2 月 24 日。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，股东可以在交易时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

公司 2010 年度第一次临时股东大会通知详见公司公告临 2010-002 号。

特此公告

方正科技集团股份有限公司董事会

2010 年 2 月 10 日

附件一：

关于公司 2009 年度配股募集资金 使用可行性报告（修订稿）议案

方正科技集团股份有限公司 2009 年度配股募集资金投入具体项目调整如下：

1、增资珠海方正高密电子有限公司用于新扩建 HDI 项目，金额不超过 56,298 万元人民币

本公司将联合上海方正科技（香港）有限公司（以下简称“香港方正”）对珠海方正高密电子有限公司（以下简称“珠海高密”）实施增资。本公司以配股资金 56,298 万元人民币增资珠海高密，香港方正以美元同比例增资。增资完成后，本公司仍持有珠海高密 75%的股权，香港方正持有珠海高密 25%股权。

增资投入珠海高密的资金全部用于新建HDI扩产项目，达产后月产能将增加30万尺。本项目计划利用珠海富山PCB产业园预留的厂房，总投资为75,064万元，其中新增固定资产投资73,600万元，项目铺底流动资金1,464万元。

经测算，项目计算期平均净利润为16,663万元，税后内部收益率为26.51%，税后投资回收期为4.23年。

2、增资珠海方正高密电子有限公司用于新建快板项目，金额不超过 15,255 万元人民币

本公司将联合上海方正科技（香港）有限公司（以下简称“香港方正”）对珠海方正高密电子有限公司（以下简称“珠海高密”）实施增资。本公司以配股资金 15,255 万元人民币增资珠海高密，香港方正以美元同比例增资。增资完成后，本公司仍持有珠海高密 75%的股权，香港方正持有珠海高密 25%股权。

增资投入珠海高密的资金全部用于新建快板项目。

本项目计划利用珠海富山PCB产业园预留的厂房，总投资为20,340万元，其中新增固定资产投资17,000万元，项目铺底流动资金3,340万元。

经测算，项目计算期平均净利润为6,176万元，税后内部收益率为30.46%，税后投资回收期为5.76年。

3、增资重庆方正高密电子有限公司用于继续建设背板项目，金额不超过 36,991

万元人民币

本公司将联合上海方正科技（香港）有限公司（以下简称“香港方正”）对重庆方正高密电子有限公司（以下简称“重庆高密”）实施增资。本公司以配股资金 36,991 万元人民币增资重庆高密，香港方正以美元同比例增资。增资完成后，本公司仍持有重庆高密 75%的股权，香港方正持有重庆高密 25%股权。

增资投入重庆高密的资金全部用于新建背板项目。项目设计年产 270 万尺背板，项目总投资为 68,242 万元人民币，其中固定资产投资 60,383 万元，铺底流动资金 7,859 万元。

经测算，项目计算期平均净利润为10,895万元，税后内部收益率为12.1%，税后投资回收期为7.35年。

本次配股募集资金净额不超过 108,544 万元人民币，投入上述三个项目。本次配股募集资金投资项目符合国家产业政策，具有良好的发展前景。项目投入不足部分公司自筹资金解决，本次配股资金到位前，公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入部分在募集资金到位之后予以偿还，本次配股资金到位后，将按项目投资计划及市场情况安排使用。

方正科技集团股份有限公司董事会

2010 年 2 月 9 日